

第11回 生産加工・工作機械部門講演会(1日目)

10月22日(土) part 1 (講演:(1) 講演時間は質疑応答を含めて15分です。(2) ○印が講演発表者です。(3) 連名者で所属が省略の方は後者と同一です。)

	A室(IB011)	B室(IB013)	C室(IB014)	D室(IB015)	
9:30		B01 OS4 生産システムとCAD・CAM① 《オーガナイザー：森重功一(電気通信大), 妻屋彰(神戸大), 成田浩久(名城大), 中本圭一(東京農工大)》 【座長：森重功一(電気通信大)】 トポロジー最適化による加工途中形状の決定手法に関する研究/○高橋辰伍, 板野健太郎, 中本圭一(東京農工大)	C01 OS11 超精密加工 《オーガナイザー：鈴木浩文(中部大), 竹内芳美(中部大), 関紀旺(慶応義塾大), 山形豊(理化学研), 福田将彦(芝機械)》 【座長：鈴木浩文(中部大)】 単結晶シリコンのスローツールサーボ旋削によるマイクロレンズアレイ加工/○向田栄央, 関紀旺(慶応義塾大)	D01 OS5 加工計測・評価 《オーガナイザー：高谷裕浩(大阪大), 高橋哲(東京大), 佐藤昌彦(鳥取大), 神谷和秀(富山県立大)》 【座長：高谷裕浩(大阪大)】 金型エッジ欠陥の自動検出/○松本哲也, 矢澤孝哲, 徳永啓樹, 宮本侑弥, 松尾寧彦(長崎大)	
9:45	A02 OS1 最新工作機械① 《オーガナイザー：白瀬敬一(神戸大), 松原厚(京大), 村木俊之(ヤマザキマザック)》 【座長：村木俊之(ヤマザキマザック)】 工作機械構造物の最適設計に関する研究/○岡田矩忠, 金亮鎮, 杉田直彦, 光石衛(京大)	B02 超精密切削加工における機上計測のためのセッティング誤差の影響解析に関する研究/○近藤良, 田村拓哉, 中本圭一(東京農工大), 竹内芳美(中部大)	C02 鋼の超音波振動切削におけるダイヤモンド工具の摩耗抑制機構に関する研究(ダイヤモンド工具の摩耗に及ぼす真空度の影響)/○水谷雄大, 糸魚川文広(名古屋工業大), 社本英二(名古屋大), 中村隆(名古屋工業大)	D02 研削砥石作業面トポグラフィのステレオ視法援用機上3次元計測システムに関する研究/○尾崎裕隆, 小松崎一氣, 周立波, 清水淳, 小貫哲平(茨城大)	
10:00	A03 高剛性・高減衰性を実現するCFRP-減衰材料複合構造体に関する研究/○藤井達也, 木崎通(京大), 岩間正俊(岩間工業所), 杉田直彦, 光石衛(京大)	B03 5軸加工を用いた歯科補綴物の高精度加工の検討/○古宮誠, 藤原亮哉, 東義隆, 宮本猛(神戸高専), 白瀬敬一(神戸大)	C03 鋼のダイヤモンド切削における工具摩耗の抑制(浸炭した鋼の組織が及ぼす影響)/○辻野元大, 古城直道, 廣岡大祐, 山口智美(関西大), 松田茂敬, 若佐康弘, 寺内俊太郎(大阪冶金興業)	D03 マイクロスケール工作機械の加工操作支援装置の開発/○齋藤明徳, 西沢秀作(日本大)	
10:15	A04 ウォータードライブスピンドルの温度測定と評価/○林晃生, 中尾陽一(神奈川大)	B04 歯科補綴物の一貫加工技術の提案/○藤原亮哉, 古宮誠, 東義隆, 宮本猛(神戸高専), 白瀬敬一(神戸大)	C04 ケルビンランプとスペーサの超精密加工による分割型中性子集光ミラーの組立て調整/○細島拓也, 竹田真宏, 河合利秀, 山形豊(理化学研), 森田晋也(東京電機大), 山田悟史, 堀耕一郎(KEK), 日野正裕, 吉永尚生, 小田達郎(京大), 武田晋, 古坂道弘(北海道大)	D04 タルボット効果を用いた3次元リソグラフィによる3次元ナノ構造形成法(露光波面が加工形状に及ぼす影響)/○篠崎充, 水谷康弘, 高谷裕浩(大阪大)	
10:30	A05 機械構造の接触問題に対する高効率・高精度解析手法の開発/○橋本洋平(金沢大), 社本英二(名古屋大), 奥村大(大阪大)	B05 データマイニングを用いたプリント基板用マイクロドリルカタログの条件設定に関する考察/○田端章吾, 廣垣俊樹, 青山栄一(同志社大), 児玉敏幸(兵庫県立大)	C05 分極状態の異なる強誘電体PMN-PT単結晶の研磨特性/○高橋秀彰, 鈴木浩文, 難波義治(中部大)	D05 表面プラズモン共鳴を用いたマイクロ光造形のインプロセス計測/○孔徳剛, 道畑正岐, 高増潔, 高橋哲(京大)	
10:45	休憩				
11:00	特別講演 佐々木 真一 氏 (トヨタ自動車株式会社 顧問・技監) 「トヨタの自工程完結“品質は工程で造り込む” (会場：IB大講義室)				
12:00	ランチョンセミナー (昼食)				
13:00	休憩				
13:15	A06 OS1 最新工作機械② 【座長：松原厚(京大)】 翼形加工試験による日本製NCと欧州製NCの比較/○佐藤隆太, 長谷川正悟, 白瀬敬一(神戸大), 岩崎孝行, 長谷川雅信, 齊藤明(HI)	B06 OS4 生産システムとCAD・CAM② 【座長：中本圭一(東京農工大)】 タクシーの移動特性を導入したAGV搬送制御におけるホモロジーを用いたコース形状の定量化/○高橋藤也, 廣垣俊樹, 青山栄一, 植崎大樹, (同志社大), 小川圭二(龍谷大)	C06 OS12 ナノ加工と表面機能 《オーガナイザー：森田昇(千葉大), 諸貴信行(首都大学東京), 金子新(首都大学東京)》 【座長：金子新(首都大学東京)】 電圧印加を併用した固体イオン交換法によるガラス中への多層構造の形成/○鈴木隆太, 川村拓史, 松坂壮太, 比田井洋史, 千葉明, 森田昇(千葉大)	D06 OS14 先端材料・難削材の加工 《オーガナイザー：関谷克彦(広島大), 坂本重彦(熊本大), 杉田直彦(京大), 大橋忠一(三菱マテリアル)》 【座長：関谷克彦(広島大), 坂本重彦(熊本大)】 ジェットクーラントを利用した旋削加工用切削工具「ジェットテックホルダー」/○清水博康(三菱マテリアル)	
13:30	A07 推定切削力を応用した不等ピッチターニングによるびびり振動抑制/○門田崇志, 山田雄基(慶應大), 中西賢一(中村留精密工業), 橋純司(ピーマック・ジャパン), 吉岡真人(京工業大), 鈴木教和(名古屋大), 柿沼康弘(慶應義塾大)	B07 Haptic Deviceを用いた5軸制御加工のためのCAMシステムの開発/○岡知哉, 森重功一(電気通信大)	C07 電界磁粒制御技術を応用した電界攪拌技術の開発(第2報)(攪拌の高効率化のための電極形状の検討)/○中村竜太, 赤上陽一, 久住孝幸(秋田県産業技術センター), 南谷佳弘, 南條博(秋田大)	D07 微細表面テクスチャを有するCBN工具によるInconel 718の高速切削加工/○杉原達哉, 榎本俊之(大阪大)	
13:45	A08 工作機械用軽量化ステージにおける制御手法の検討/○山田雄基, 山本智之, 柿沼康弘(慶應義塾大), 飯島一憲, 若下平輔, 須藤雅子(ファナック)	B08 可操作度およびワーク配置を考慮したロボットプログラムの最適化(シーリング作業への適用)/○佐藤裕太, 森重功一(電気通信大)	C08 Au薄膜のトランスファプリントに関する研究(スタンプ形状の影響およびMEMSへの応用)/○片山泰良, 柴納響平, 森章洋, 川畑敦士, 金子新(首都大学東京)	D08 前切れ刃形状を直線にしたボールエンドミルによるCFRP板のヘリカル加工に関する研究/○坂本重彦, ○有島敬太(熊本大)	
14:00	A09 振動操作関数によるNC工作機械送り系軌道の離散サンプル値制御(減衰を考慮しない場合について)/○小竹茂夫(三重大)	B09 複雑形状の深溝加工を対象とした工具姿勢計画手法(溝内部での工具折り返しにおける機械軸動作を考慮した自動計画法の開発)/○市川康平, 金子順一(埼玉大), 長谷川雅信, 岩崎孝行(HI), 堀尾健一郎(埼玉大)	C09 微細構造と親水性単分子修飾の組合せによる油滴除去機能面/○諸貴信行, 宮本貴翔(首都大学東京)	D09 SUS304旋削時に生じる凝着(コーティング工具を用いた場合)/○関谷克彦(広島大), 渡辺祥央(出光興産), 田邊翔希, 山田啓司(広島大)	
14:15		B10 削り残り形状に対応した工具の干渉回避手法の開発/○渡邊健人, 金子順一, 堀尾健一郎(埼玉大)	C10 電場印加状態の制御によるアクリル樹脂の付着特性制御手法の開発/○村島基之, 梅原徳次(名古屋大), 上坂裕之(岐阜大)	D10 SUS304断続切削時における切削モードが凝着物の安定性に与える影響/○田邊翔希, 関谷克彦(広島大), 渡辺祥央(出光興産), 田中隆太郎, 山田啓司(広島大)	
14:30					

企業パネル・機器展示 (会場：IB電子情報館廊下)

10月22日(土) part 2 (講演:(1) 講演時間は質疑応答を含めて15分です。(2) ○印が講演発表者です。(3) 連名者で所属が省略の方は後者と同一です。)

	A室(IB011)	B室(IB013)	C室(IB014)	D室(IB015)	企業パネル・機器展示(会場：B電子情報館廊下)	
14:30	A11 OS1 最新工作機械③ 【座長：白瀬敬一(神戸大)】 左右ボールネジカウンタバランス送り駆動系を有する工作機械の特性とマイクロドリル加工特性／○岸本昌大, 廣垣俊樹, 青山栄一(同志社大)					
14:45	A12 アイドリングストップ機能を有するコンパクト5軸制御工作機械による省電力な加工法／○太田諒, 青山栄一, 廣垣俊樹(同志社大)	B12 OS8 電気加工① 《オーガナイザー：岡田晃(岡山大), 谷貴幸(筑波技術大), 江頭快(京都工芸繊維大), 早川伸哉(名古屋工業大)》 【座長：平尾篤利(新潟大)】 超短電圧パルスを用いた電解加工による微細穴あけ加工／○平井優, 林亮夫, 江頭快, 山口桂司, 太田諒(京都工芸繊維大)	C12 GS1 一般セッション① 《オーガナイザー：社本英二(名古屋大), 上田隆司(名古屋大), 鈴木教和(名古屋大), 藤巻俊介(名古屋大)》 【座長：鈴木教和(名古屋大)】 熱硬化性樹脂の制振性に及ぼすフィラー条件の影響／○酒井康徳(東京工業大), 田中智久(名古屋大), 朱疆(東京工業大)	D12 OS6 切削加工① 《オーガナイザー：白杵年(島根大), 松村隆(東京電機大), 笹原弘之(東京農工大), 金子順一(埼玉大)》 【座長：松村隆(東京電機大)】 静圧空気軸受に支持された回転軸におけるエンドミル加工時の回転軸振れに関する数値的研究／○若林大介, 宮武正明, 吉本成香(東京理科大)		
15:00	A13 超多機能多工程集約複合加工機の開発(第1報)(基本コンセプトと加工機能ユニットの評価)／○吉井大祐, 中野剛嗣, 佃勇気, 太田諒, 江頭快, 山口桂司(京都工芸繊維大)	B13 放電加工によるチタン製人工関節コンポーネントへの骨伝導性付与／○利光良太, 王瑞祥, 岡田晃(岡山大), 木村光臣(帝人ナカシマメディカル)	C13 パニシング加工によるグラファイトの鏡面加工／○近藤佑樹, 井原之敏, 田中佑弥, 坂本慎季(大阪工業大)	D13 小径ボールエンドミル加工におけるリード角とびびり振動の関係評価／○齊藤明, 長谷川雅信(HI), 社本英二(名古屋大)		
15:15	A14 CNC旋盤における熱変形挙動の解明／○榎大悟, 大西孝, 大橋一仁(岡山大), 下田陽一郎, 末竹孝全, 山田憲一, 三宅成人(滝澤鉄工所)	B14 クロム粉末混入放電加工による金型の表面機能向上／○王瑞祥, 利光良太(岡山大), 北田良二(崇城大), 岡田晃(岡山大)	C14 工具回転機能を有したダイヤモンドチップパニシング加工(残留応力による仕上げ面評価)／○松原弘, 新谷正義(金沢大), 岡田将人(福井大), 立矢宏(金沢大)	D14 高能率深溝加工の実現に向けての取り組み(モードカップリング型びびり振動抑制のための臨界接触角度の導出)／○早坂健宏, 浦畑悠子, 藤巻俊介, 社本英二(名古屋大)		
15:30			C15 ロードセルを内蔵した工具を用いたSUS420材のボールパニシング加工／○澤田準一, 朱疆(東京工業大), 修芳伸(国立台湾科技大), 吉岡勇人(東京工業大)	D15 切削工具の曲率を考慮した初期びびり振動発生モデル(滑らかでない接触点軌跡が生む分散調波振動)／○小竹茂夫, 永田結貴(三重大)		
15:45	A16 OS2 最新機械要素技術① 《オーガナイザー：藤井健次(THK), 由井明紀(防衛大), 吉岡勇人(東京工業大)》 【座長：廣垣俊樹(同志社大)】 可変絞り型水潤滑静圧スラスト軸受の静特性に関する研究／○福山一樹, 宮武正明, 吉本成香(東京理科大)	B16 OS8 電気加工② 【座長：江頭快(京都工芸繊維大)】 プラズマ放電改質に関する基礎的研究(成膜メカニズム及び改質効果の検討)／○江川諒仁, 京泉朋希, 加藤千拓, 徐少林, 嶋田慶太, 水谷正義, 厨川常元(東北大)				
16:00	A17 超微細加工用高速回転水潤滑軸受に関する研究／○牧野亮介, 保福優樹, 宮武正明, 吉本成香(東京理科大)	B17 高速回転工具を用いた高アスペクト比の微小径穴加工／○平尾篤利(新潟大), 谷貴幸(筑波技術大), 毛利尚武(東京大)	C17 GS1 一般セッション② 【座長：田中智久(名古屋大学)】 機能性子タンクラッド容器の深絞り加工性／○服部修治, 原田泰典(兵庫県立大)	D17 OS6 切削加工② 【座長：笹原弘之(東京農工大)】 エンドミル加工における工作機械駆動系の挙動と切削力の時間領域連成シミュレーション／○野口晋, 佐藤隆太, 白瀬敬一(神戸大)		
16:15	A18 弾性ヒンジを用いたアクティブ制御型油静圧スラスト軸受に関する研究／○上滝晃一, 宮武正明, 吉本成香(東京理科大)	B18 電子軌道解析による大面積電子ビーム照射現象の基礎的研究／○木村恭彰, 前田幸輝, 篠永東吾, 岡田晃(岡山大)	C18 樹脂複合金型による純チタン薄板の深絞り加工性／○原田泰典, 服部修治, 野瀬田翔伍(兵庫県立大)	D18 傾斜切削理論に基づくエンドミル加工の切削力予測モデルの提案／○金子和暉, 西田勇, 佐藤隆太, 白瀬敬一(神戸大)		
16:30	A19 水静圧スピンドルの温度変化の測定／○桐ヶ谷裕, 林晃生, 中尾陽一(神奈川大)		C19 肩部回転ダイを用いた波面容器の成形性／○原田泰典(兵庫県立大)	D19 高精度ボールエンドミル加工のための幾何学的評価指標の提案／○寺井久宣, 浅尾晃通(北九州高専), 吉川浩一(九州工業大)		
16:45			C20 精度保証加工のための加工誤差要因の推定に関する研究(工作物把持による加工誤差への影響評価)／○古川大樹, 寺本孝司(室蘭工業大)	D20 ヘリカルミリングの切削力解析／○河野亮, 松村隆(東京電機大)		
17:00	休憩					
17:30	懇親会 (会場：名古屋大学東山キャンパス内生協 南部食堂)					
19:30						

第11回 生産加工・工作機械部門講演会(2日目)

10月23日(日) part 1 (講演:(1) 講演時間は質疑応答を含めて15分です。(2) ○印が講演発表者です。(3) 連名者で所属が省略の方は後者と同一です。)

	A室(IB011)	B室(IB013)	C室(IB014)	D室(IB015)	
9:00				D21 OS6 切削加工③ 【座長：臼杵年(島根大)】 難削材加工に適応可能な従動式ロータリミーリング工具の開発/○加藤裕也, 鈴木教和, 社本英二(名古屋大), 内木幸夫(三菱重工業), 高木優次(三菱マテリアル)	
9:15	A22 OS2 最新機械要素技術② 【座長：宮武正明(東京理科大)】 直動転がり案内における表面粗さと位置偏差変動の関係/○大高一馬, 河野大輔(京都市大), 三浦徹也(THK), 松原厚(京都市大)		C22 OS13 環境適応型加工① 《オーガナイザー：若林利明(香川大), 糸魚川文広(名古屋工業大), 酒井克彦(静岡大)》 【座長：酒井克彦(静岡大)】 水溶性加工液の多重リサイクル使用に関する研究/○山口顕司, 生田智大(米子高専), 近藤康雄(山形大), 坂本智(横浜国立大), 藤田剛(米子高専)	D22 難削材加工における工具寿命向上技術/○犬飼亮太, 石原洋成, 稲垣浩, 成松昌洋(オクマ)	
9:30	A23 超精密直動転がり案内テーブルにおける Masing 則に基づいた摩擦特性補償/○磯田颯, 吉岡勇人, 新野秀憲(東京工業大)		C23 非塩素系切削油の検討/○辻本鉄平, 八木下和宏(JX エネルギー), 若林利明(香川大)	D23 固体潤滑シートによるチタン合金板の穴あけ加工におけるバリ発生抑制/○川崎貴之, ○梅原徳次(名古屋大), 上坂裕之(岐阜大), 野老山貴行(秋田大), 堀江茂(三菱瓦斯化学), 松山洋介(米沢ダイアエレクトロニクス)	
9:45	A24 マシニングセンタにおける高速・高出力主軸の開発/○受井嘉治, 下村亮一, 森村章一, 吉村辰浩(オクマ)		C24 硫化油脂添加油を用いたステンレス鋼の MQL 切削(水ミストとの併用効果)/○糸魚川文広, 中村隆(名古屋工業大), 千本木則夫, 須田聡(JX エネルギー)	D24 固体潤滑シートを用いたチタン合金の穴あけ加工におけるバリ高さに及ぼすドリル表面テクスチャリングの影響/○大山慎太郎, 梅原徳次(名古屋大), 上坂裕之(岐阜大), 鄧興瑞, 村島基之(名古屋大), 堀江茂(三菱ガス化学), 松山洋介(米沢ダイアエレクトロニクス)	
10:00	A25 超磁歪素子駆動回転形高速工具サーボによるフライス加工状態のインプロセス認識/○田村勇樹(東京工業大), Andreas Relard(Univ. of Hanover), 吉岡勇人, 新野秀憲(東京工業大)	B25 OS9 レーザ応用加工① 《オーガナイザー：古本達明(金沢大), 岡本康寛(岡山大), 池野順一(埼玉大), 比田井洋史(千葉大)》 【座長：関紀旺(慶応義塾大)】 温度・熱応力解析に基づいたレーザー援用研削における加工条件決定に関する研究/○田邊祥太, 木崎通(東京大), 岩間正俊(岩間工業所), 杉田直彦, 光石衛(東京大)	C25 複合ミスト供給システムを用いたチタン合金のニアドライ加工/○若林利明, 山田圭祐, 小池将太(香川大), 熱田俊文(香川県産業技術センター)		
10:15		B26 レーザによる穴あけと穴内面への成膜を同時に行う加工法に関する研究/○佐藤俊, 比田井洋史, 松坂壮太, 千葉明, 森田昇(千葉大)		D26 OS6 切削加工④ 【座長：笹原弘之(東京農工大)】 一方向 CFRP のドリル加工における工具刃数と切削力特性/○田村昌一, 中野佑一(栃木県産業技術センター), 松村隆(東京電機大)	
10:30	A27 OS2 最新機械要素技術③ 【座長：吉岡勇人(東京工業大)】 マシニングセンタを用いて抽出した繊維のみの成形歯車のかみあいモニターと考察/○橋本淳志, マクシムロナ, 廣垣俊樹, 青山栄一(同志社大), 小川圭二(龍谷大), 野辺弘道(三藤機械製作所)	B27 表面圧縮応力の異なる化学強化ガラスのレーザー切断特性/○扇子悠, 古本達明, 橋本洋平, 小谷野智広, 細川晃(金沢大)	C27 OS13 環境適応型加工② 【座長：糸魚川文広(名古屋工業大)】 マシニングセンタの熱変位補償制御に関する研究/○山下俊一, 島名賢児, 松尾征一郎, 吉満真一(鹿児島高専), 桜庭肇, 東大貴(キラ・コーポレーション), 河野良弘(準人テクノ)	D27 CFRP 材の穿孔加工における切削温度の影響/○赤木智成, 萩野将広(津山高専), 井上孝司(大同大)	
10:45	A28 金属光造形適気性金型による低エネルギー成形を目的とした射出成形時の電力削減効果(射出成形条件による樹脂充填率と消費電力の関係)/○吉岡亮祐, 榎原弘之, 是澤宏之(九州工業大)	B28 Molten Area Characteristics in Micro-welding of Glass by Picosecond Laser/○Imaduddin Helmi Bin Wan Nordin, Yasuhiro Okamoto, Akira Okada, Motoki Ota (Okayama Univ.), Tomokazu Sakagawa (Kataoka Corp.)	C28 リアルタイム熱変位補正技術の開発/○榎井康匡, 岩井英樹, 佐々木雄二, 平野稔(シエイテクト)	D28 チタン合金のドリル切削における動的挙動に関する研究(切れ刃の振れを考慮した切削力解析)/○米本直樹, 松村隆(東京電機大)	
11:00	A29 NC 旋盤の熱変位補正に関する研究/○井戸悠(DMG 森精機), 松原厚(京都市大), 高山直士, 中南成光(DMG 森精機)	B29 ナノ秒レーザーを用いた軟鋼材の加工においてパルス幅が材料到達エネルギーに及ぼす影響/○伊藤瑞菜, 篠永東吾, 岡本康寛, 岡田晃(岡山大)	C29 工具磨耗抑制を考えた 5 軸仕上げ加工/○内方創士, 竹内芳美(中部大)	D29 プリント配線板の小径穴あけ加工における切りくず排出機構に関する研究/○永澤亮浩, 吉村博仁(新潟大), 渡邊英人(ユニオンツール)	
11:15	休憩				
11:30	特別講演 千田 治光 氏 (オクマ株式会社 技術本部本部長) 「これからのものづくりを支えるスマートファクトリーとスマートマシン」 (会場：IB大講義室)				
12:30	ランチョンセミナー (昼食)				
13:30	休憩				
13:45	休憩				

企業パネル・機器展示 (会場：1B 電子情報館廊下)

10月23日(日) part 2 (講演:(1) 講演時間は質疑応答を含めて15分です。(2) ○印が講演発表者です。(3) 連名者で所属が省略の方は後者と同一です。)

	A室(IB011)	B室(IB013)	C室(IB014)	D室(IB015)	
13:45	A30 OS3 工具・ツーリング① 《オーガナイザー：加藤秀治(金沢工業大), 坂本治久(上智大), 岡田将人(福井大), 赤松猛史(日立ツール)》 【座長：岡田将人(福井大)】 スーパーニ相ステンレス鋼を対象としたコーテッド超硬工具の切削性能に関する研究(切削速度の違いが工具損傷に及ぼす影響)／○大高力, 加藤秀治(金沢工業大), 和田昌浩(中村留精密工業)	B30 OS9 レーザ応用加工② 【座長：岡本康寛(岡山大)】 エパネッセント露光型ナノ光造形法に関する研究(エパネッセント露光用光硬化性樹脂の開発)／○松本侑己, 鈴木裕貴, 道畑正岐, 高増潔, 高橋哲(東京大)	C30 OS10 研磨技術 《オーガナイザー：榎本俊之(大阪大), 鈴木恵友(九州工業大), 鄒艶華(宇都宮大)》 【座長：杉原達哉(大阪大)】 電界ラッピング技術における研磨砥粒挙動の基礎検討／○久住孝幸, 池田洋, 中村竜太, 赤上陽一(秋田県産業技術センター)	D30 OS6 切削加工⑤ 【座長：松村隆(東京電機大)】 CVD ダイヤモンドコーティングエンドミルによる超硬合金切削加工時の工具損傷(WC 粒子径と Co 含有量が工具摩耗に及ぼす影響)／○佐橋えりな, 糸魚川文広, 見並朋哉, 中村隆(名古屋工業大)	企業パネル・機器展示(会場・・・B 電子情報館廊下)
14:00	A31 小径ボールエンドミルを用いた超弾塑性型チタニウム合金の微細加工に関する研究(切削温度及び切削抵抗が加工変質層に及ぼす影響)／○伊藤江平, 加藤秀治, 池永訓昭(金沢工業大)	B31 ダブルパルスレーザーによるワイドバンドギャップ半導体の光励起加工／○林照剛, 松永啓伍, 黒河周平, 横尾英昭, 松川洋二(九州大)	C31 機械研磨によるダイヤモンド表面の高精度平滑化／○久保田章亀, 峠睦(熊本大)	D31 バインダレス cBN 工具によるねずみ銹鉄の高速切削における仕上げ面粗さの改善／○桑原怜也, 酒井克彦, 静弘生(静岡大)	
14:15	A32 高硬度鋼加工における cBN 工具の摩耗形態に関する研究／○矢野雅大, 宮下庸介(三菱マテリアル)	B32 ピコ秒レーザーアブレーションによる金型鋼の加工特性／○小林知貴, 嶋本悠里(慶應義塾大), 石田宏, 若林知敬(矢崎総業), 関紀旺(慶應義塾大)	C32 OS7 研削・砥粒加工① 《オーガナイザー：山田高三(日本大), 大橋一仁(岡山大), 吉原信人(岩手大), 嶋田慶太(東北大)》 【座長：山田高三(日本大)】 研削品質向上技術の回転軸衝撃力緩和と振動低減理論の実証実験／○今岡善次郎, 夏恒(東京農工大)	D32 サーメット工具の切れ刃損耗におけるフラクタル次元評価／○ユザイリアブドゥル ラヒーム, 清水毅, 萩原親作(山梨大)	
14:30		B33 レーザ誘起湿式改質における溶液成分が SUS316L 鋼の改質層形成に及ぼす影響／○江面篤志, 大川弘暉(慶應義塾大), 片平和俊(理化学研), 小茂鳥潤(慶應義塾大)	C33 振動抑制のための回転軸衝撃力緩和の理論的検証／○今岡善次郎(東京農工大)	D33 ワイヤ+アーク放電による AM と切削加工との連携システムの開発／○永松秀朗(東京農工大), 光武祐介(武藤工業), 濱元剛(ムトーアイテックス), 高木悠貴, 笹原弘之(東京農工大)	
14:45	A34 OS3 工具・ツーリング② 【座長：加藤秀治(金沢工業大)】 Ni 基耐熱合金の旋削加工における被削材組織と CBN 工具の損傷／○千原健太郎, 原田高志, 岡村克己(住友電気工業), 久木野暁(住友電工ハードメタル)	B34 骨足場への Er:YAG レーザ照射時の温度測定／○天野裕晴, 古本達明, 橋本洋平, 小谷野智広, 細川晃(金沢大)			
15:00	A35 ダイヤモンドコーテッド超硬工具による超硬合金のドリル加工(切削特性の基礎的検討)／○志田涼輔, 岡田将人(福井大), 渡邊英人(ユニオンツール), 大津雅亮(福井大)		C35 OS7 研削・砥粒加工② 【座長：嶋田慶太(東北大)】 砥石内研削液供給機構における砥石要目が砥石表面温度と仕上げ面粗さに及ぼす影響／○鈴木修平, 福原義也, 笹原弘之(東京農工大)	D35 OS6 切削加工⑥ 【座長：金子順一(埼玉大)】 窒化金型材の硬さと工具先形状が切削抵抗に及ぼす影響／○長谷川達郎, 成田浩久(名城大)	
15:15	A36 ダイヤモンドコーテッド超硬工具を用いた超硬合金のエンドミル加工(切削条件による仕上げ面の検討)／○鈴木裕日至, 岡田将人(福井大), 渡邊英人(ユニオンツール), 大津雅亮(福井大)		C36 ダイヤモンド砥粒電着金網砥石の開発とそれによる CFRP 穿孔加工／○鈴木光希, 子安玲(東京農工大), 伊藤幸男(電算機応用研), 福原義也(東京農工大), 武田幸久(ニートレックス), 松原守(名光精機), 八尾泰弘(平和産業), 野村幸作, 笹原弘之(東京農工大)	D36 Whirling 切削機構による表面加工／○芹沢正規, 松村隆(東京電機大)	
15:30			C37 ハイレシプロ研削法による耐熱合金の研削加工／○吉原信人, 福田佑太, 寶満正嗣, 西川尚宏, 水野雅裕(岩手大)	D37 振動ホブ切り加工法における切削温度の検討／○軽部周, ○江口侑希(大分高専)	
15:45					